

## ECE認定プログラム コース

## 要素技術コース

要素プロセス技術1 リソグラフィコース		要素プロセス技術2 エッチングコース		要素プロセス技術3 成膜コース		要素プロセス技術4 組立コース	
1	フォトマスク作製 レーザー描画	4	シリコン異方性エッチング	12	パリレン薄膜形成 パリレン	6	陽極接合
2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ	7	シリコンドライエッチング D-RIE	13	金属薄膜形成1 ECRスパッタ	18	ウェーハ切断 ダイサー
15	レジスト塗布 コートデベ	8	ガラスドライエッチングNLD	15	レジスト塗布 コートデベ	19	パッケージ
16	転写プロセス ナノインプリント	14	加工表面観察	17	金属薄膜形成2 4元スパッタ	20	デバイス接合 アッシャー

## デバイスコース

デバイス1 バルクマイクロマシニング海老名集中コース (ナノ・マイクロ流路形成)		デバイス2 サーフェスマイクロマシニングコース (電極/配線形成)	
3	シリコン酸化	2	精密リソグラフィ 両面マスクアライナ
4	シリコン異方性エッチング	7	シリコンドライエッチング D-RIE
5	ナノパターン形成	13	金属薄膜形成1 ECRスパッタ
6	陽極接合	15	レジスト塗布 コートデベ

## ECE認定プログラム

要素プロセス技術1, 2, 3, 4, デバイスコース1, 2

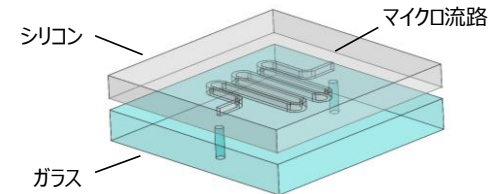
## ECE認定基準

3/4以上受講

満たない場合、レポート（アンケート）提出

## シリコンマイクロ流路の例)

実習はシリコンマイクロ流路形成と陽極接合



## 電極/配線の例)

実習はAu/Crスパッタとウェットエッチング

